

ZPMV2.E76251 - Wiring, Printed - Component

Wiring, Printed - Component

WUERTH ELEKTRONIK GMBH & CO KG
SALZSTR 21
NIEDERNHALL, 74676 Germany

E76251

Type	Cond Width		Cond Thk	SS/ DS	Max Area Diam	Report date	Surface Mount Technology	Assembly Solder Process Temp °C	Solder Process Cycles	Solder Limits °C sec	Max Oper Temp °C	Flame Class	Meets UL796 DSR	C T	
	Min mm	Min Edge mm													
Multi layer printed wiring boards															
50	0.076	0.229	4.5 Int:99	DS	127	No	-	-	-	288	20	130	V-0	All	3
52	0.076	0.229	5 Int:35	DS	25.4	No	-	-	-	288	20	130	V-0	All	*
52A	0.076	0.229	5 Int:35	DS	25.4	No	-	-	-	288	20	130	V-1	All	*
53 (c)	0.076	0.228	5 Int:99	DS	25.4	No	-	-	-	288	20	130	V-1	All	*
53B (c)	0.076	0.228	5 Int:99	DS	12.7	No	-	-	-	288	20	130	V-0	All	*
54	0.076	0.229	4.5 Int:99	DS	127	No	-	-	-	288	20	130	V-0	All	*
59	0.05	0.05	5 Int:70	DS	50.8	No	-	-	-	288	20	130	V-0	All	3
59A	0.05	0.05	5 Int:70	DS	50.8	No	-	-	-	288	20	130	V-0	All	3
59B	0.05	0.05	20 Int:70	DS	50.8	No	-	-	-	288	20	130	V-0	All	3
Multilayer Flexible Materials Interconnect connections (FMIC) with Flammability Classification only															
56	-	-	-	DS	-	No	-	-	-	288	20	-	V-0	-	-
65	-	-	-	DS	-	No	-	-	-	288	17	-	V-0	-	-
65A	-	-	-	DS	-	No	-	-	-	288	17	-	V-1	-	-
Multilayer metal based printed wiring boards, flammability only Recognition															
58	-	-	-	SS	-	No	-	-	-	288	20	-	V-0	-	-
Multilayer printed wiring boards															
51B (ASP 1)	0.05	0.05	5 Int:70	DS	50.8	Yes	Yes	260	6	-	-	130	V-0	All	*
912	0.08	0.15	17 Int:175	DS	76	No	-	-	-	288	20	130	V-0	All	*
913	0.08	0.08	12 Int:70	DS	25.4	No	-	-	-	260	5	130	V-0	All	-
										260	5				
Multilayer printed wiring boards, flammability only Recognition															
51	-	-	-	DS	-	No	-	-	-	288	20	-	V-0	-	-
51A	-	-	-	DS	-	No	-	-	-	288	20	-	V-1	-	-
80	-	-	-	DS	-	No	-	-	-	288	20	-	V-0	-	-
83	-	-	-	DS	-	No	-	-	-	288	20	-	V-0	-	-
Multilayer rigid flex composite, flexible materials interconnect constructions, flammability only Recognition															
82	-	-	-	DS	-	Yes	Yes	260	6	288	20	-	V-0	-	-
Multilayer rigid flex composite, flexible materials interconnect constructions, for flex-to-install/rigid applications.															
57 (Note 2) (Note 3) (Note 4)	0.075	0.075	5 Int:70	DS	25.4	Yes	Yes	260	6	-	-	105	V-0	▲	-
Multilayer Rigid/Flex-to-Install Printed Wiring Boards															
66 @	0.075	0.20	18 Int:70	DS	25.4	No	-	-	-	288	20	120	V-1	All	4
67 @	0.075	0.20	35 Int:35	DS	25.4	No	-	-	-	288	20	120	V-0	All	3
68 @	0.075	0.20	35 Int:35	DS	25.4	No	-	-	-	288	20	120	V-1	All	2
Single layer printed wiring boards															
11	0.076	0.229	16.5	DS	127	No	-	-	-	288	20	130	V-0	All	3
12	0.076	0.229	5	DS	25.4	No	-	-	-	288	20	130	V-0	All	*
12A	0.076	0.229	5	DS	25.4	No	-	-	-	288	20	130	V-1	All	*
14	0.076	0.229	16.5	DS	127	No	-	-	-	288	20	130	V-0	All	*
911	0.08	0.15	17	DS	50.8	No	-	-	-	288	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards, flammability only Recognition															
13	-	-	-	DS	-	No	-	-	-	288	20	-	V-0	-	-

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

- Various conductor thicknesses, Refer to Report dated August 29, 1978.

% - Various board types; refer to reprt dated 1972-07-20

(ASP 1) - Assembly solder process evaluated to IPC-TM-650, 2.6.27 Thermal Stress Assembly Simulation

(c) - Board employs embedded, uninsulated wires welded to copper foil

(Note 2) - This construction is DS in the main build-up portion and SS in the reduced thickness milled-down section

(Note 3) - Max external Cu in reduced thickness milled-down portion is 60 microns. No Internal Copper in milled down portion.

(Note 4) - Milled down portion is limited to MAD of 25.4mm, Rigid portion is limited to MAD of 50.8.

@ - Minimum external Cu thickness in the rigid portion is 12 mic. Maximum internal Cu thickness in rigid portion is 70 mic. Minimum external and maximum internal Cu values indicated refers to flexible portion of the board.

Marking: Company name or tradename "WE" or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or flammability classification..

Last Updated on 2023-04-06

Der Umstand, dass der Name oder das Produkt eines Unternehmens in dieser Datenbank aufgeführt ist, garantiert nicht, dass die Herstellung der jeweiligen Produkte dem Follow-Up-Service von UL unterliegt. Nur Produkte mit UL-Zeichen gelten als zertifiziert und sind vom Follow-Up-Service von UL abgedeckt. Prüfen Sie daher stets, ob ein Produkt das UL-Zeichen trägt.

UL gestattet die Weiterverwendung der im Online-Zertifizierungsverzeichnis enthaltenen Materialien unter den folgenden Bedingungen: 1. Alle Anleitungen, Baugruppen, Konstruktionen, Designs, Systeme und/oder Zertifizierungen (Dateien) müssen vollständig und auf nicht irreführende Weise ohne Manipulation der Daten (oder Zeichnungen) dargestellt werden. 2. Bei Weiterverwendung von Materialien muss der Vermerk „Aus dem Online-Zertifizierungsverzeichnis mit Genehmigung von UL nachgedruckt“ stets mit angegeben werden. Darüber hinaus muss das nachgedruckte Material einen Urheberrechtsvermerk in folgendem Format enthalten: "©2023 UL LLC"

This document is © 2023 UL LLC

Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from UL